

LG화학, 휴대기기용 RCC 라인 증설

빌드업 PCB 핵심소재 ... 생산능력 2배 확대로 시장점유율 44% 목표

LG화학이 핸드폰, PDA(개인휴대단말기), 노트북과 같은 휴대기기에 주로 사용되는 빌드업 PCB(인쇄회로기판)의 핵심소재인 RCC(Resin Coated Copper) 생산능력을 확대한다.

LG화학은 RCC 생산능력 확대를 위해 총 60억원을 투자하고 청주공장에 한해 생산능력 300만㎡ 규모의 RCC 신규라인 증설을 시작해 2004년 5월부터 본격 가동에 들어갈 계획이라고 설명했다.

신규증설과 병행해 기존 생산라인의 생산성 향상 활동을 전개함으로써 2004년 2/4분기에는 현재의 3배 이상인 600만㎡의 RCC 생산능력을 확보할 계획이다.

특히, 최근 급성장하고 있는 타이완, 중국시장의 시장점유율을 높이기 위해 해외마케팅 역량 강화에 집중하는 한편, 2006년까지 생산규모를 한해 1300만㎡로 확대하고 세계시장의 44%를 점유한다는 계획이다.

LG화학 회로소재사업부장인 이희재 수석부장은 "PCB 시장의 회복 기대와 함께 국내 및 타이완 PCB 생산 기업들의 수요증가가 진행됨에 따라 빌드업 PCB의 핵심부품인 RCC 시장도 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되며, 2004년에는 신규라인 증설에 힘입어 2003년보다 90억원이 많은 240억원 매출을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

한편, RCC 세계시장 규모는 2004년 1200억원으로 추산되며 매년 13% 이상 고성장세를 보여 2008년에는 2500억원에 이를 것으로 예상되고 있다.

<Chemical Journal 2003/10/30>